



Rework Schablone

Mit Rework-Schablonen werden Bauteile definiert gedippt (in Flussmittel oder Lotpaste eingetaucht) oder exakt bedruckt. Auch eine Kombination beider Anwendungen ist möglich, wenn z.B. an einem Bauteil die Massefläche bedruckt und die Beinchen gedippt werden.

Dip-Schablone

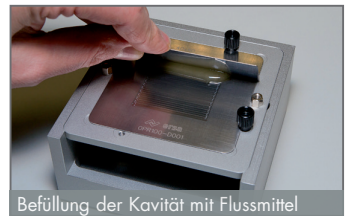
Die Tiefe der Kavität in der Dip-Schablone gibt die Flussmittel bzw. Pastenhöhe am Bauteile vor. Das Dip-Medium wird in die Kavität gerakelt. Anschließend wird das Bauteil in das Medium getaucht und bis zum Boden der Kavität abgesenkt.

Beim nachfolgenden Heben des Bauteils bleibt eine reproduzierbare Menge des Dip-Mediums an der Oberfläche der Bauteilanschlüsse haften und steht somit für die Reparaturlötung bereit.

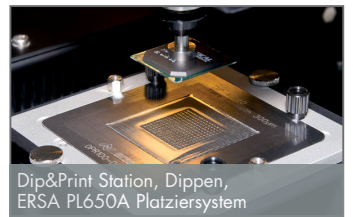
Dieses Verfahren eignet sich für BGA-Bauformen in allen Größen und für Bauteile, die über einen ausreichend großen Höhenunterschied zwischen Beinchen und Bauteilkörper verfügen.

Druckschablone

Mit einer bauteilspezifischen **Rework-Schablone** werden Bauteile ohne Beinchen, z.B. QFN- oder MLF-Bauformen, direkt bedruckt. Auch BGAs oder die Masseflächen von QFP-Bauformen können direkt bedruckt werden. Die Vorrichtung fixiert das Bauteil und die Schablone, um die Handhabung zu vereinfachen. Der Druckprozess stellt eine reproduzierbare Lotmenge für die Lötung bereit.



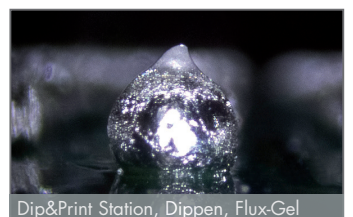
Befüllung der Kavität mit Flussmittel



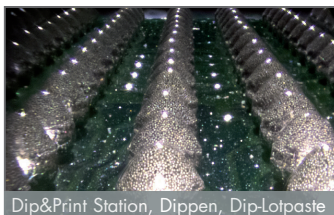
Dip&Print Station, Dippen, Ersa PL650A Platziersystem



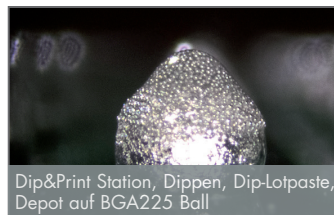
Dip&Print Station, Dippen, Flux-Gel auf BGA225 Balls



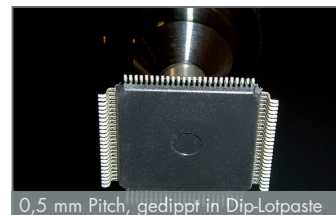
Dip&Print Station, Dippen, Flux-Gel



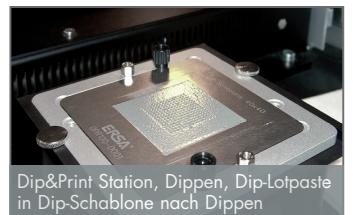
Dip&Print Station, Dippen, Dip-Lotpaste



Dip&Print Station, Dippen, Dip-Lotpaste, Depot auf BGA225 Ball



0,5 mm Pitch, gedippt in Dip-Lotpaste



Dip&Print Station, Dippen, Dip-Lotpaste in Dip-Schablone nach Dippen